



表面贴装型 CX1008SB (消费类电子产品应用/ 移动通信应用)

1.0×0.8mm



RoHS指令对应产品

■特点

- 超小型、薄型
(1.0×0.8×0.3mm max.)
- 可对应通信设备频率
- 可对应自动装配、回流焊
- 陶瓷封装保证高可靠性

■用途

- 移动通信

■型号表示方法

CX1008SB 37400 □□ □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列名称

②频率

③负载容量

④频率容差
(常温偏差)

B0	6 pF	—	F	±10×10 ⁻⁶	标准
C0	7 pF	标准	G	±15×10 ⁻⁶	—

⑤工作温度范围以及⑥频率温度特性

LH	-30 ~ +85° C	±12×10 ⁻⁶
-----------	--------------	----------------------

⑦个别规格

包装方式(载带包装 21000个/卷盘)

■规格

项 目	记 号	标准规格	单 位	备 注
频率	f _{nom}	37400 ~ 80000	kHz	
泛音次数	OT	Fundamental	—	
负载容量	CL	7	pF	其他负载容量, 敬请咨询。
频率容差	f _{tol}	±10	×10 ⁻⁶	25° C ±3° C
串联电阻	R1	Table 1	ohm	
激励级	DL	Table 2	μW	
工作温度范围	T _{use}	-30 ~ +85	° C	
储存温度范围	T _{stg}	-40 ~ +105	° C	
频率温度特性	f _{tem}	±12	×10 ⁻⁶	

以上规格为规格示例, 如需其他规格, 敬请咨询。

■Table1 串联电阻

频率范围	串联电阻
f _{nom} =37400~80000kHz	60Ω max.

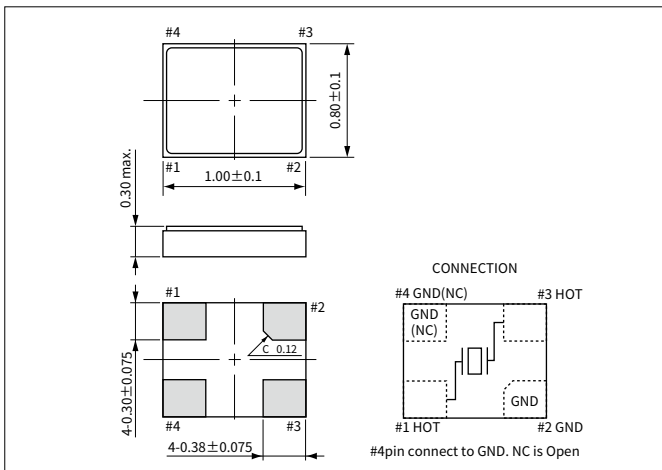
■Table2 激励级

频率范围	激励级
f _{nom} =37400~80000kHz	10μW (100μW max.)

晶
体
谐
振
器

■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)

